



2026 年 10 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニ レ コ
代 表 者 名 代表取締役社長 中杉 真一
(コード番号：6863 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役執行役員管理部門長
佐々田 卓也
(TEL 042-642-3111)

株式会社 YGK の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、2026 年 10 月 30 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社 YGK（以下「YGK」といいます。）の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

YGK は、半導体用ウエハ検査装置等の設計、製造及び販売を行う企業であり、半導体ウエハの表面キズや異物を検出する微細検査技術及びノウハウを有しています。また、SiC、GaN、ガラス基板等の次世代材料向け検査技術の開発にも取り組んでいます。

当社グループは、画像処理、光学及び制御等の技術を基盤として、幅広い産業分野に製品及びサービスを提供しています。また、本年策定した中期経営計画「NIRECO-VISION 100」では、既存事業の競争力強化と成長分野への事業展開を推進する方針を掲げています。YGK が有する半導体ウエハ検査技術、製品開発力及び顧客基盤は、当社グループの技術及び事業基盤との補完性が見込まれることから、本件株式取得を通じて、技術情報、顧客情報及び市場情報の共有等による製品開発力及び販売力の強化並びに半導体製造・検査装置分野における事業機会の拡大が期待できると判断し、同社株式を取得して子会社化することといたしました。

2. 異動する子会社（株式会社 YGK）の概要

(1)	名 称	株式会社 YGK
(2)	所 在 地	山梨県南アルプス市曲輪田 595 番地 2
(3)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 深津 邦夫
(4)	事 業 内 容	半導体用ウエハ検査装置等の設計、製造及び販売
(5)	資 本 金	20 百万円
(6)	設 立 年 月	1994 年 4 月
(7)	大 株 主 及 び 持 株 比 率	高石 修二 90.8%、他 個人株主 5 名 (9.2%)
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係：該当事項はありません。 人的関係：該当事項はありません。 取引関係：該当事項はありません。 関連当事者への該当状況：該当事項はありません。

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態				
	2024年6月期	2025年6月期	2026年6月期	
純 資 産	430 百万円	589 百万円	886 百万円	
総 資 産	594 百万円	773 百万円	1,252 百万円	
1 株 当 たり 純 資 産	1,076,888.83 円	1,473,089.73 円	2,215,907.56 円	
売 上 高	497 百万円	614 百万円	1,016 百万円	
営 業 利 益	101 百万円	211 百万円	443 百万円	
経 常 利 益	106 百万円	211 百万円	443 百万円	
当 期 純 利 益	76 百万円	158 百万円	297 百万円	
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	191,719.60 円	396,200.90 円	742,817.83 円	
1 株 当 たり 配 当 金	－円	－円	－円	

3. 株式取得の相手先の概要

(1)	氏 名 ・ 住 所	高石 修二（山梨県南アルプス市）ほか5名
(2)	上 場 会 社 と 当 該 個 人 と の 関 係	当該個人との間に、資本関係・人的関係・取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1)	異動前の所有株式数	0 株 (議決権の数：0 個) (議決権所有割合：0%)
(2)	取得株式数	400 株 (議決権の数：400 個)
(3)	取得価額	株式会社 YGK の普通株式 1,600 百万円 アドバイザー費用等（概算額） 6 百万円 合計（概算額） 1,606 百万円
(4)	異動後の所有株式数	400 株 (議決権の数：400 個) (議決権所有割合：100.0%)

5. 日程

(1)	取締役会決議日	2026 年 10 月 30 日
(2)	株式譲渡契約締結日	2026 年 10 月 30 日（予定）
(3)	株式譲渡実行日	2026 年 11 月 20 日（予定）

6. 今後の見通し

本件株式取得による当社の 2027 年 3 月期連結業績に与える影響については、現時点では確定しておりません。新たな業績予想等については、YGK を第 4 四半期会計期間から連結することを前提として、11 月 13 日に予定している 2027 年 3 月期第 2 四半期決算の発表のタイミングを目途に公表する予定です。また、中期経営計画「NIRECO-VISION 100」についても、数値目標の修正を行う予定です。YGK の業績予想については、今後 5 年間、売上高 8 ～ 10 億円、営業利益 3 億円台後半から 4 億円強の水準感となることを想定しています。なお、YGK の報告セグメントについては、同社の当社グループにおける事業上の位置付け及び管理体制等を踏まえて検討中です。本件株式取得に伴い発生が見込まれるのれんについては、現在算定中であり未確定ではあるものの、約 6 億円を想定しています。のれんの金額、償却期間などは 2027 年 3 月期第 3 四半期決算において確定する予定です。

YGK が有する半導体ウエハ検査技術及び製品開発力は、当社グループが有する光学、画像処理及び制御等の技術との親和性が高いものと考えています。同社がニレコグループに加わることにより、半導体製造・検査装置業界向けに、光学結晶、光学部品、薄膜製造、レーザ装置及び検査装置をグループで取り扱うことから、技術情報、顧客情報及び市場情報の共有などを通じて、製品開発力及び販売力の強化を図ってまいります。

本件株式取得により当社グループの中長期的な成長を一層加速できるものと期待しています。

以 上

株式会社 YGK の株式取得 (子会社化) に関する説明資料

光学技術の融合で
「はかる・みつける・ととのえる」を強化

NIRECO-VISION 100

人と生産現場に寄り添い
課題を「はかる・みつける・ととのえる」

2026 年 10 月 30 日

株式会社ニレコ 証券コード：6863

本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手した情報に基づく予想であり、潜在的なリスクや不確実性を含んでおります。したがって、実際の業績は様々な要因により、これらの予想と異なる場合があることをご承知おきください。



SiC/GaNウエハ表面パーティクルスキャナ
YPI-MX-DC SMIF

本件の概要

株式取得により YGK を連結子会社化

半導体ウエハ検査装置の高収益事業を獲得し、グループの事業機会を拡大

対象会社
株式会社 YGK

取得比率
100.0%

決議日
2026年10月30日

取得価額
16億円
※アドバイザリー費用等を除く

狙い

半導体検査分野の拡充

光学・レーザ技術と
ウエハ検査技術を融合

技術・顧客基盤の拡張

国内外での販売機会と
開発力を強化

高収益事業の獲得

2026 年 6 月期
売上高 1,016 百万円
／営業利益 443 百万円

株式会社 YGK について

山梨県の半導体ウエハ検査装置メーカー



YGK本社外観

「新たな検査価値の創造」に挑戦

主要取引先 (納入先)

国立極地研究所／福岡大学／山梨大学／アルプス電気／TDK／ディスコ／信越化学工業
住友電気工業／デンソー／三井化学／ローム／富士電機／ソニーセミコンダクタ

設立	1994年4月
所在地	山梨県南アルプス市曲輪田595-2
代表者	代表取締役社長 深津 邦夫
資本金	2,000万円

事業内容

半導体用ウエハ・各種検査装置の設計から販売
静電気関連／気中・液中パーティクル
検査装置の設計から製造

従業員数 24名

主力製品

ウエハ表面からダイシング後工程、ガラス基板まで対応

ウエハ表面パーティクルスキャナ
YPI-MX-DC



SiC/GaN ウエハ対応
355 nm レーザ搭載

SiC ウエハ表面のパーティクルやスクラッチを検出。出荷検査やパワー半導体製造ラインのプロセスモニター、洗浄工程の確認に使用

ウエハ表面パーティクルスキャナ
YPI-MX FOUN



300 mm ウエハ・FOUP 対応
量産ライン向け

300 mm ウエハ用FOUPオープナを搭載したYPI-MX の拡張モデル。OHTやオンラインなど多様なシステム運用に対応

ダイシングウエハ表面
パーティクルスキャナ YPI-MX TF



ダイシング後の
テープフレームウエハ対応

ウエハ上のパーティクル測定や保護膜剥離後の糊残渣の確認が可能。後工程のプロセス・装置開発用モデル

ガラス基板研磨確認装置
XGS



ガラス基板全面を
非接触で高速検査

ガラス基板のキズや欠陥を可視化。光散乱強度分布マップのほか、パーティクル検査も可能

企業や大学・研究所向けにパーティクル測定装置を提供。ウエハ表面・ダイシングウエハ表面・ガラス基板の検査装置を、半導体・MEMS・センサーなど幅広い業界に販売

YGK の競争力

光散乱技術を核に、多様なウエハ・工程を検査

01 微細検査技術

レーザ照射で生じる表面・異物からの光散乱を計測し、高速にマップ化。
透明ウエハでも表面のみを計測する技術を保有。

02 次世代材料への対応

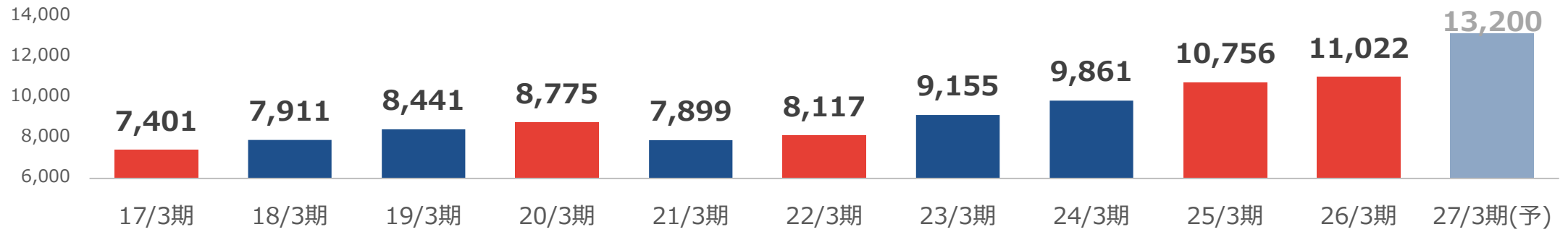
シリコンに加え、SiC・GaN、透明ウエハ、ガラス基板へ展開。
YPI-MX-DC は SiC ウエハの高感度測定に対応。

03 装置化・工程対応

ウエハ検査装置の設計から販売までを手がける。
研究開発向けから量産ライン、ダイシング後の検査まで製品を展開。

M&Aを通じた成長の軌跡

2017年以降のM&Aを通じ、オプティクス・検査機・電子基板の各領域を拡大
連結売上高の推移（百万円）



2017年 （株）メガオプト

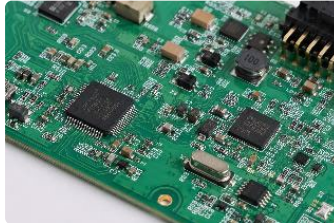
オプティクス
深紫外ファイバーレーザ
「Cygnus」/固体・
ファイバーレーザ

※2019年にニレコに吸収合併



2019年 （株）光学技研

オプティクス
CLBO結晶加工・偏光子・
プリズム等の
高精度光学部品
（NASA宇宙望遠鏡計画等
を含む）



2021年
西武電機（株）
**その他セグメント（電子基
板）**
電子機器の設計・
基板製造・実装
（JAXA宇宙分野等を含む）



2024年
京浜光膜（株）
オプティクス
光学薄膜（フィルター・
ミラー）の
真空蒸着加工



2025年
応用光研工業（株）
検査機／オプティクス
放射線計測機器・
シンチレータ結晶・
高純度光学結晶

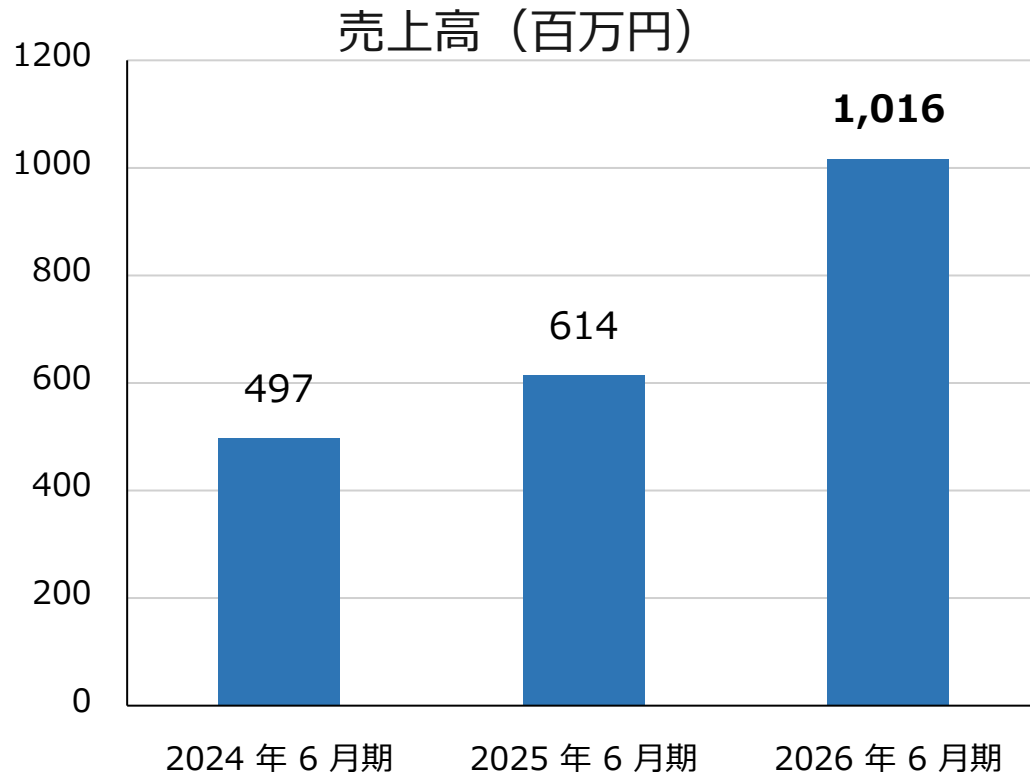


2026年（本件） （株）YGK

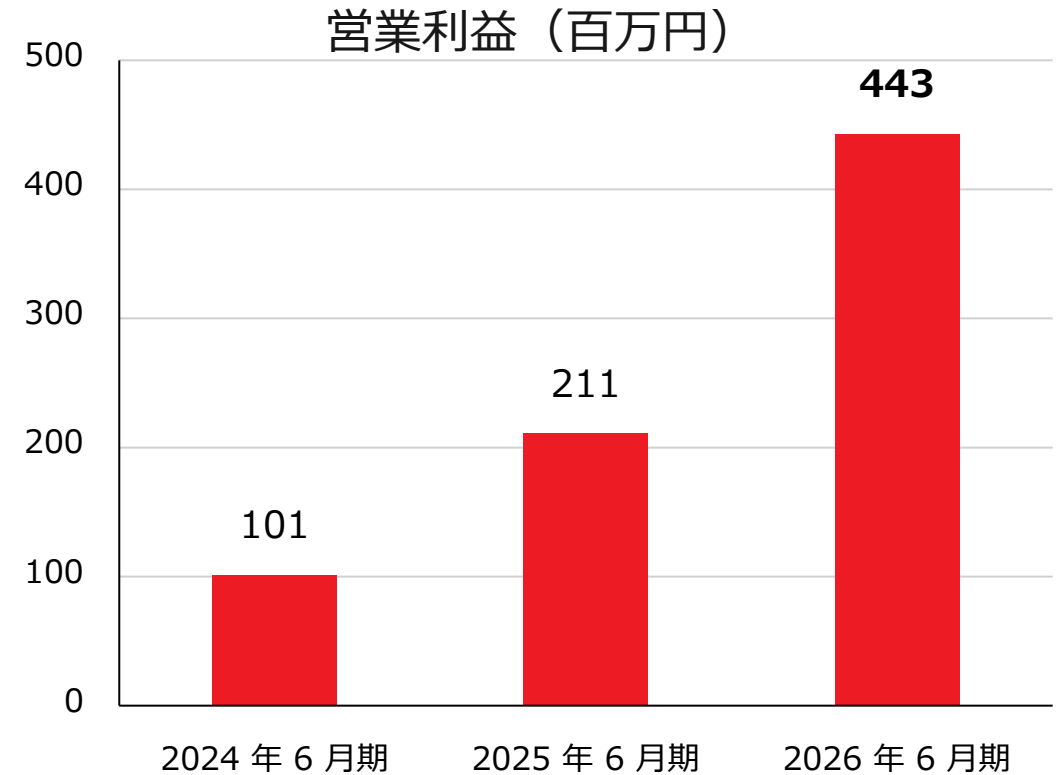
半導体ウエハ検査装置
光散乱技術による
表面パーティクル検査
SiC・GaN、ガラス基板
などに対応

YGK業績推移

直近年度は売上高・利益とも大幅に伸長



売上高 前期比 +65%



営業利益 前期比 +110%

今後5年間に想定するYGKの年間業績水準

今後5年間のYGK業績想定

売上高

8～10億円

営業利益

3億円台後半～4億円強

- ・ 業績・配当予想は11月13日の第2四半期決算発表時に公表予定
(第4四半期からYGKの連結を前提)
- ・ のれんの金額は算定中 (約6億円を想定)
償却期間等は2027年3月期第3四半期決算で確定予定
- ・ 中期経営計画「NIRECO-VISION 100」の数値目標も修正予定
- ・ YGKの報告セグメントは事業上の位置付けなどを踏まえて検討中

本件の意義

グループの成長戦略を支える M&A

- 1 半導体検査装置を事業ポートフォリオへ追加
- 2 光学・レーザ技術の川下展開を実現
光学部材と検査装置をつなぐ技術の融合
- 3 高収益事業と顧客基盤を獲得
収益基盤を強化し、持続的な成長へ
- 4 **NIRECO-VISION 100 の実現を加速**
人と生産現場に寄り添い、課題を「はかる・みつける・ととのえる」



光学技術の融合で「はかる・みつける・ととのえる」を強化

NIRECO